

4971 **メック**

前田 和夫 (マエダ カズオ)

メック株式会社社長

高付加価値新製品の開発・販売に注力し増収増益

◆上期上方修正計画を達成

平成 27 年 3 月期第 2 四半期の連結業績は、売上高が 45 億円(前年同期比 7 億 39 百万円増)となり、平成 26 年 7 月 31 日発表の上期上方修正計画を達成した。為替の影響による増収分は 1 億 76 百万円である。セグメント別の売上高については、薬品が 41 億 68 百万円(同 6 億 55 百万円増)、機械が 46 百万円(同 6 百万円減)、資材が 2 億 74 百万円(同 97 百万円増)となった。

売上総利益は、高付加価値薬品売上の増加や未実現利益の減少により 29 億 10 百万円(前年同期比 5 億 68 百万円増)となった。販売費および一般管理費は、旅費交通費や発送運賃の増加により 18 億 55 百万円(同 1 億 14 百万円増)となった。為替の影響による増加分は 51 百万円である。その結果、営業利益は 10 億 54 百万円(同 4 億 54 百万円増)となり、修正計画を 54 百万円上回った。為替の影響による増益分は 30 百万円である。

その結果、経常利益は 10 億 92 百万円となり、修正計画を 92 百万円上回った。四半期純利益は 7 億 11 百万円で、修正計画を 61 百万円上回った。

売上高に占める薬品の割合は 92.6%(前年同期比 0.8 ポイント減)となった。海外売上高比率は 51.5%(同 4.0 ポイント増)となった。ただし、当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は 72.2%であり、前年同期の 61.4%から大きく伸びている。CZ の売上高は 21 億 93 百万円(同 22.5%増)となった。薬品売上高に占める割合は 52.6%(同 1.6 ポイント増)である。粗利率は 64.7%(同 2.4 ポイント増)となった。

第 2 四半期の業績を第 1 四半期と比較すると、売上高は順調に伸び、営業利益は若干落ちている。経常利益は同等で、四半期純利益は若干増えている。

品種別売上高は薬品が増加し、特に銅表面処理剤が伸びている。薬品を密着向上剤、エッチング剤、その他表面処理剤に分けて分析すると、密着向上剤では CZ シリーズ、エッチング剤では EXE シリーズが伸び、薬品売上高全体を押し上げた。CZ シリーズは、スマートフォンやタブレット PC 等のパッケージ基板に用いられる高密度・高多層電子基板向けに銅と樹脂との密着を飛躍的に向上させる。EXE シリーズは、ディスプレイ用の半導体搭載電子基板向けとして高密度配線パターンを実現する。

通期の連結業績については、第 1 四半期に上方修正した数値を据え置き、売上高は 88 億円(前期比 10.0%増)、営業利益は 17 億 50 百万円(同 23.1%増)、経常利益は 17 億 50 百万円(同 12.8%増)、当期純利益は 11 億円(同 18.9%増)を見込んでいる。

◆金属表面処理技術で世界を拓く

当社の製品は、スマートフォン・タブレット PC、自動車、医療機器、ウェアラブル、テレビ、各種家電、パソコン、デジカメ、カーナビ等さまざまな用途向けの電子部品に使用されている。特にスマートフォン市場の拡大は業績に大きく寄与している。同市場自体は成熟してきているが、当社製品は、生産の効率化のため使われる副資材であることから、主資材の後から遅れて需要がついてくるため、今後も引き続き期待できると考えている。

当社のコア技術は、密着向上技術、微細配線形成技術および表面処理技術である。密着向上技術には、物理的に金属を粗化して密着強度を上げる物理密着技術と、金属を粗化せず分子間で結合させる化学密着技術とがある。微細配線形成技術は、エッチング剤を用いてサブトラクティブ工法により微細な配線を形成する技術を中心とする。その他表面処理技術は、金属表面粗化技術と選択エッチング技術を中心とする技術である。

◆自動車やネットワーク関係に期待

今後期待が持てる分野として、自動車に関しては、自動運転システムが実用化段階に入ってきて、今後、自動車が「大きな電気製品」になっていくところに大きな期待を寄せている。「ぶつからないクルマ」には、ミリ波レーダー、可視光カメラ、サーバー、数多くのセンサーが搭載される。また、車載サーバーはネットワークに組み込まれるという動きになってきており、ネットワークの多様化と自動車の進化、あるいは自動車がネットワークの中に入っていくという動きが非常に顕在化してきている。今後はセンサー関係や通信関係が伸びていくと考えている。

通信関係では、伝送スピードの向上が重要課題となっている。まずは、携帯電話基地局の需要増に大きな期待を寄せている。また、伝送スピードが上がると電気が導体の表層近くを走るため、できるだけ銅金属表面をフラットな状態で電気を流す必要がある。そこで、当社では、フラットな状態で導体と樹脂等の密着強度を上げるフラットボンドプロセスを開発し磨きをかけていて、この需要が立ち上がってきたと考えている。

パッケージ基板に関しては、現在、CZ-8101 が好調である。しかし、生産性向上とコスト低減のため配線ピッチが細くなっていき、それに従ってパッケージ基板の配線パターンも細くしていく必要がある。その需要に応えるため、より細かく粗化することにより CZ-8101 と同等あるいはそれ以上に密着強度を上げられる CZ-8201 を開発した。今後はこれの売り込みに注力していく。その先はフラットボンドを広めていきたい。

新型スマートフォンに関しては、アプリケーションプロセッサのパッケージに CZ シリーズが使われている。

テレビに関しては、4K・8K の次世代テレビの普及や、ブラジル・中国・ロシアのデジタルテレビ化に期待している。この分野でデファクトスタンダードになっているディスプレイ向け EXE シリーズがじわじわと業績に寄与してくると考えている。

メックブライght EXE シリーズについては、スマートフォンのマザーボードやフレキシブル基板向けに売り込もうと考えている。通常とほぼ同じ生産性を持ちエッチング方法によるパターン作成で高密度化のニーズに応えていく。

アマルファは、更なる軽量化、密封化、工程の簡略化等のニーズに応えていく金属表面処理技術である。ステンレスやアルミ、ニッケル等さまざまな金属といろいろな種類の樹脂の組み合わせで対応していく。中長期的に事業の柱にしようと考えていて、一歩ずつ前進しているところである。

◆事業領域拡大と更なる成長を目指す

これまで電子基板製造関連分野を事業領域としてきたが、ディスプレイ関連分野や、その他樹脂金属接合関連分野へも拡大しつつある。特に、その他樹脂金属接合関連分野については、大きな柱に育てていきたいと考えている。

今後も成長し続けるためには、まず、グローバル展開を強化していく。アジアだけでなく欧米も視野に入れていかななくてはならない。また、競合と決定的な差をつけるために、新製品の開発力とトータルな品質保証力を強化していく。

◆ 質 疑 応 答 ◆

第 3 四半期の見通しを教えてください。

ここ数年、第 3 四半期は好調であるが、一部顧客が年末に向けてスマートフォンを減産するなど、良い面と悪い面が交錯しているの見通しがつけにくい。現時点で、不安視する要素は特段ないが、華々しく業績が上がるかどうかは、確証を持って言える段階にはない。

競合に対する強みと課題を教えてください。

当社の事業の特色として、完全な B to B であり、製品が副資材であることから、競合が少ない。主力製品の CZ は、強力な競合が実質的にいない状態である。半導体パッケージを中心に長年使われてきた中で、一度もクレームを起こしたことがないという実績を持ち、他社からの参入障壁はかなり高いと考えている。今後も他社を寄せ付けない製品を数多く開発していかなければならないが、非常に時間がかかる技術分野であることが経営課題である。できるだけ効率よく開発し市場に投入していくことに努めつつも、粘り強くデファクトに近い状態に仕上げていくことが非常に重要であると考えている。

コストアップした場合も価格転嫁は容易なのか。

Win-Win の関係でやりたいと考えているので、ダイレクトな価格アップではなく、製品の機能を引き上げたうえで価格の改定を行っている。

スマートフォン・タブレット PC 市場における CZ の採用比率はどのくらいか。

パッケージ基板については、CZ が使える部分はすべて獲得できている。今後は、新たに工程が増えていく部分について採用の余地がある。マザーボードについては、最外層の前処理に 2 割程度使われている。したがって、マザーボードでシェアアップしていけば大きく増える可能性はある。ただし、マザーボードの場合は、CZ 以外にも粗化の方法があり、パッケージほど信頼性を要求されないため、多少の競争があっても簡単にはいかないと考えている。

(平成 26 年 11 月 4 日・東京)

* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。

http://www.mec-co.com/ir/k_setsumei/